

- (iv) have a compressive strength of less than 14 MN/m², and
- (v) are not capable of withstanding temperatures above 177°C.

Electronic Component Assemblies, Printed Circuit Boards, Substrates, Microcircuits and Packages

1564 (1) In this item,

- “assembly” means a number of components, including circuit elements, discrete components and integrated circuits, that are connected together to perform one or more specific functions and that are replaceable as an entity; (*ensemble*)
- “basic gate power dissipation” means the power-dissipation value that corresponds to the basic gate utilized within a family of monolithic integrated circuits and that may be specified either as the power dissipation per typical gate or as the typical power dissipation per gate within that family; (*puissance dissipée de porte de base*)
- “basic gate propagation delay time” means the propagation delay-time value that corresponds to the basic gate utilized within a family of monolithic integrated circuits and that may be specified either as the propagation delay-time per typical gate or as the typical propagation delay-time per gate within that family; (*retard de propagation de la porte de base*)
- “circuit element” means a single active or passive functional part in an electronic circuit; (*élément de circuit*)
- “discrete component” means a separately packaged circuit element that has its own external connections; (*composant discret*)
- “film-type integrated circuit” means an array of circuit elements and metallic interconnections that is formed by the deposition of a thick or thin film on an insulating substrate; (*circuit intégré à film*)
- “hybrid integrated circuit” means any combination of integrated circuits, circuit elements or discrete components that are connected together to perform one or more specific functions; (*circuit intégré hybride*)
- “manufacturer” has the same meaning as in item 1529; (*fabricant*)
- “microcomputer microcircuit” means a monolithic integrated circuit or multichip integrated circuit that contains an ALU that is capable of executing general purpose instructions from an internal storage on data contained in the internal storage; (*microcircuit micro-ordinateur*)
- “microprocessor microcircuit” means a monolithic integrated circuit or multichip integrated circuit that contains an ALU capable of executing a series of general purpose instructions from an external storage, and that normally does not contain integral user-accessible storage, although storage present on-the-chip may be used in performing its logic function; (*microcircuit microprocesseur*)
- “microprogram” means a sequence of elementary instructions that are maintained in a special storage, the execution of which is initiated by the introduction of its reference instruction into an instruction register; (*microprogramme*)
- “module” means a number of electronic components, that is, circuit elements, discrete components or integrated circuits, that are connected together to perform one or more functions and that are replaceable as an entity; (*module*)

- (iv) ont une résistance à la compression de moins de 14 MN/m²,
- (v) sont incapables de résister à des températures de plus de 177 °C.

Ensembles de composants électroniques, plaques de circuits imprimés, substrats et microcircuits

1564 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

- «circuit intégré à film» Réseau d'éléments de circuit et d'interconnexions métalliques formé par le dépôt d'un film mince ou épais sur un substrat isolant. (*film type integrated circuit*)
- «circuit intégré à microplaquettes multiples» Circuit contenant au moins deux circuits intégrés monolithiques fixés sur un substrat commun. (*multichip integrated circuit*)
- «circuit intégré hybride» Toute combinaison de circuits intégrés, d'éléments de circuit ou de composants discrets reliés ensemble afin d'exécuter une ou plusieurs fonctions spécifiques. (*hybrid integrated circuit*)
- «circuit intégré monolithique» Combinaison de plusieurs éléments de circuit passifs ou actifs ou des deux qui sont fabriqués par des processus de diffusion, d'implantation ou de dépôt sur ou dans un élément semi-conducteur unique. (*monolithic integrated circuit*)
- «circuit intégré optique» Circuit intégré monolithique ou hybride, contenant un ou plusieurs éléments, conçu pour fonctionner comme dispositif photosensible, photo-émissif ou pour exécuter une ou plusieurs fonctions optiques ou électro-optiques. (*optical integrated circuit*)
- «composant discret» Élément de circuit en boîtier séparé, possédant ses propres connexions externes. (*discrete component*)
- «élément de circuit» Élément fonctionnel actif ou passif unique dans un circuit électronique. (*circuit element*)
- «ensemble» Un certain nombre de composants tels que les éléments de circuit, composants discrets et microcircuits, reliés ensemble pour accomplir une ou plusieurs fonctions spécifiques qui sont remplaçables globalement. (*assembly*)
- «fabricant» S'entend au sens de l'article 1529. (*manufacturer*)
- «logiciel» Collection d'un ou de plusieurs programmes ou microprogrammes fixés sur tout support d'expression tangible. (*software*)
- «microcircuit micro-ordinateur» Circuit intégré monolithique ou circuit intégré à microplaquettes multiples contenant une ULA capable d'exécuter des instructions universelles à partir d'une mémoire interne, sur des données contenues dans la mémoire interne. (*microcomputer microcircuit*)
- «microcircuit microprocesseur» Circuit intégré monolithique ou circuit intégré à microplaquettes multiples contenant une ULA capable d'exécuter, à partir d'une mémoire externe, une série d'instructions universelles et qui ne contient pas normalement de mémoire accessible à l'utilisateur incorporée, bien qu'une mémoire sur la microplaquette puisse être utilisée pour exécuter sa fonction logique. (*microprocessor microcircuit*)
- «microprogrammabilité accessible à l'utilisateur» Possibilité pour l'utilisateur d'insérer, de modifier ou de remplacer les microprogrammes. (*user accessible microprogrammability*)